

多芯片封装解决方案

低功耗DRAM + e-MMC™

应用

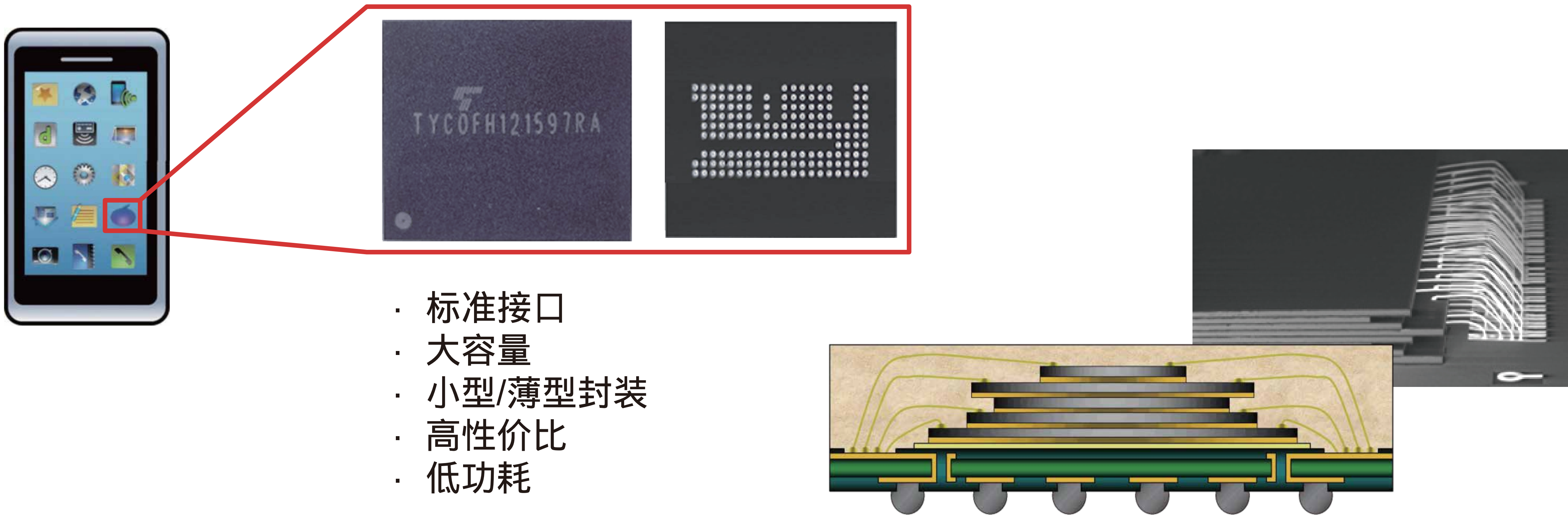
- > 伴随着智能手机等移动设备多功能化的发展趋势，高速处理大量数据的需求日益增强。移动设备的内部空间有限，对多芯片封装（MCP）需求也越来越大。

特点

- > 将东芝最尖端的15nm NAND技术、NAND控制器技术、封装技术融为一体
- > JEDEC标准接口
- > 丰富的存储容量组合
- > 先进的层叠封装技术，带来最适用于移动设备的小型封装

产品阵容

- > 提供RAM、ROM各种容量组合的产品。随着近年大容量ROM的市场需求日益增强，配置有e-MMC™和LPDDR2的多芯片封装eMCP产品阵容也不断充实
- > 配置v5.0标准的e-MMC™和芳LPDDR3的eMCP产品已经量产



- 标准接口
- 大容量
- 小型/薄型封装
- 高性价比
- 低功耗

8芯片封装产品截面图

东芝eMCP产品线

			e-MMC™		
			4GB	8GB	16GB
LPDDR2 162ball eMCP 11.5mm × 13mm		4Gb	可供货	可供货	-
		8Gb	可供货	可供货	可供货
LPDDR3 221ball eMCP 11.5mm × 13mm		4Gb	可供货	-	-
		8Gb	可供货	可供货	可供货
		16Gb	-	-	开发中